

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-43675

(P2002-43675A)

(43)公開日 平成14年2月8日(2002.2.8)

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テームト [*] (参考)
H 0 1 S 5/022		H 0 1 S 5/022	2 H 0 3 7
G 0 2 B 6/42		G 0 2 B 6/42	5 F 0 7 3
H 0 1 L 31/02		H 0 1 L 31/02	B 5 F 0 8 8

審査請求 未請求 請求項の数5 O L (全 6 頁)

(21)出願番号 特願2000-223328(P2000-223328)

(22)出願日 平成12年7月25日(2000.7.25)

(71)出願人 000004008

日本板硝子株式会社

大阪府大阪市中央区北浜四丁目7番28号

(72)発明者 田中 裕之

大阪府大阪市中央区道修町3丁目5番11号

日本板硝子株式会社内

(72)発明者 橘爪 秀樹

大阪府大阪市中央区道修町3丁目5番11号

日本板硝子株式会社内

(74)代理人 100078961

弁理士 茂見 穰

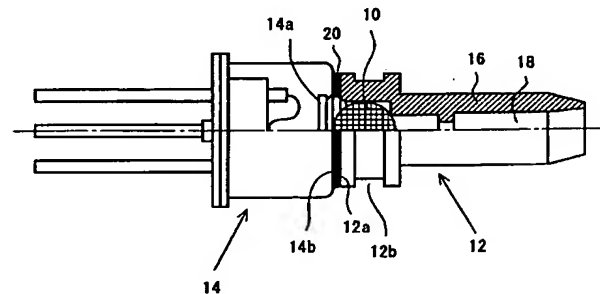
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 光モジュール

(57)【要約】

【課題】 細径化してLC型やMU型など小型の光コネクタにも対応できるようにする。ダブレットタイプなどにも容易に適用できるように小型化する。

【解決手段】 キャップ封止型の光半導体素子14が、内部に光部品を収容しているハウジング12に対して、該光部品の光軸上に位置するように芯だして取り付けられている。その際、光半導体素子のキャップ上面とハウジングの端面が突き合わされて接着(紫外線硬化型接着剤20)固定されている。この構造の光モジュール本体を用い、光半導体素子のキャップ側面とハウジング側面の少なくとも一部を覆うようにケーシングを被せて樹脂封止することもできる。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 キャップ封止型の光半導体素子が、内部に光部品を収容しているハウジングに対して、該光部品の光軸上に位置するように芯だして取り付けられている光モジュールにおいて、

光半導体素子のキャップ上面とハウジングの端面が衝き合わされた状態で接着固定されていることを特徴とする光モジュール。

【請求項 2】 キャップ封止型の光半導体素子が、レンズを内蔵すると共に接続相手の光プラグのフェルールを嵌合保持する構造のハウジングに対して、該レンズの光軸上に位置するように芯だして取り付けられている光モジュールにおいて、

光半導体素子のキャップ上面とハウジングの端面が衝き合わされた状態で接着固定されていることを特徴とする光モジュール。

【請求項 3】 光半導体素子のキャップ側面とハウジング側面の少なくとも一部を覆うようにケーシングを被せて間隙部を樹脂封止した請求項 1 又は 2 記載の光モジュール。

【請求項 4】 光半導体素子のキャップ上面とハウジングの端面は紫外線硬化型接着剤で接着固定され、ケーシング内面と光半導体素子のキャップ側面及びハウジング側面の少なくとも一部の間隙部は熱硬化性樹脂で封止されている請求項 3 記載の光モジュール。

【請求項 5】 請求項 1 又は 2 記載の光モジュールが複数個並置され、それらに共通のケーシングを被せ、間隙部が樹脂封止されている光モジュール。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、キャップ封止型の光半導体素子と、内部に光部品を収容しているハウジングとを、光学的最適位置関係で衝き合わせ接着固定した細径構造の光モジュールに関するものである。

【0002】

【従来の技術】光モジュールは、光半導体素子（例えばレーザダイオード等の半導体発光素子あるいはフォトダイオード等の半導体受光素子）と光部品（例えばレンズや光ファイバフェルール等）とを調芯保持したデバイスである。光通信分野において使用されている光モジュールとしては、例えば、光半導体素子と、レンズと、前記光半導体素子やレンズを保持すると共に接続相手の光プラグのフェルールを嵌合保持するハウジングから構成され、光プラグ接続時に光半導体素子とフェルールの光ファイバとがレンズを介して光学的に結合する構造がある。光ファイバとの光学的結合は、通常、各種光コネクタの標準規格に準拠した機械的構造による。

【0003】光モジュールに組み込むレンズとしては、機械加工のみによって高精度の製品を容易に製造できるため安価であり、且つ方向性が全く無いためにレンズ実

装の際の方位調整が不要で組み立て易いという利点もあって、球レンズが多用されている。その他、非球面レンズや屈折率分布型ロッドレンズ等も用いられる。光半導体素子やレンズを保持するハウジングは、かつては金属製のハウジングが多用されていたが、最近ではレンズをインサートモールドで内蔵したり複数の爪状突起で抱持することが可能なことなど、製作用性が優れ且つコストを低減できるといった観点から樹脂製のハウジングが用いられることも多い。光半導体素子としては、通常、素子本体を窓付きキャップ内に装着して封止した所謂キャップ封止構造のものが多く用いられている。

【0004】光モジュールを製造するには、通常、光半導体素子、レンズ、ファイバを光学的に最適な位置関係に調芯し、レンズを内蔵しているハウジングに光半導体素子を固定する。例えば光半導体素子がレーザダイオードの場合、レーザダイオードを動作させ、その出射光を光ファイバから取り出し、取り出したレーザ出射光の光量が最大になる位置で、ハウジングと光半導体素子を固定する。

【0005】キャップ封止型光半導体素子を用いた従来の光モジュールでは、ハウジング内に光半導体素子のキャップを挿入可能な構造になっており、光半導体素子のステム部とハウジングの端面とを接合している。ハウジングが樹脂製の場合には各種の接着剤を用い、金属製の場合には YAG 溶接することもある。いずれにしてもハウジングの一部が光半導体素子のキャップ側面全周を覆うような状態で接合されている。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】近年、光通信容量の増大に伴って、光伝送装置などでは光ファイバを高密度実装する必要性が高まっている。このため、これらに搭載される光モジュールも、より一層の小型化が要求されている。具体的には、従来の SC 型光コネクタから LC 型や MU 型など小型の光コネクタへの対応が求められている。

【0007】しかし、上記のようにキャップ封止型光半導体素子を用いた従来の光モジュールでは、光モジュールの外径は、必然的に光半導体素子のステム部の直径よりも大きくなり、小型化・細径化が制限されていた。

【0008】本発明の目的は、小型の光モジュールを提供することである。本発明の他の目的は、LC 型や MU 型など小型の光コネクタにも対応できる光モジュールを提供することである。本発明の更に他の目的は、ダブレットタイプなどにも容易に適用できる小型の光モジュールを提供することである。

【0009】

【課題を解決するための手段】本発明は、キャップ封止型の光半導体素子が、内部に光部品を収容しているハウジングに対して、該光部品の光軸上に位置するように芯だして取り付けられている光モジュールである。ここ

で本発明では、光半導体素子のキャップ上面とハウジングの端面が衝き合わされた状態で接着固定されており、その点に特徴がある。従って、光モジュールの最大外径を光半導体素子の最大外径以下に収めることが可能となる。

【0010】ハウジング内に収容する光部品としては、例えばレンズや光ファイバフェルールなどがある。ハウジングは、レンズを内蔵するだけの構造でもよいし、レンズを内蔵すると共に接続相手の光プラグのフェルールを嵌合保持する構造などでもよい。後者の場合には、キャップ封止型光半導体素子をレンズ及びフェルールの光軸上に位置するように芯だししてハウジングと光半導体素子とを固定する。本発明は、光半導体素子とフェルールボアを直接接着する光モジュールにも適用できる。通常、ハウジングは合成樹脂製であり、ハウジングと光半導体素子のキャップ上面との接合には紫外線硬化型接着剤が好ましいが、他の接着剤を用いてもよい。

【0011】また本発明には、上記の光モジュールを用い、光半導体素子のキャップ側面とハウジング側面の少なくとも一部を覆うようにケーシングを被せて間隙部を樹脂封止した構成もある。この構成においては、光半導体素子のキャップ上面とハウジングの端面は紫外線硬化型接着剤で接着固定され、ケーシング内面と光半導体素子のキャップ側面及びハウジング側面の少なくとも一部の間隙部は熱硬化性樹脂で封止されている構造が好ましい。紫外線硬化型接着剤による接着は、極く短時間で接着できるため光学的最適位置での結合作業が容易となるし、熱硬化性樹脂を用いた封止により接着強度及び耐候性能の向上を図ることができる。

【0012】更に本発明には、上記の光モジュールを複数個並置し、それらに共通のケーシングを被せ、間隙部が熱硬化性樹脂で封止されている構造もある。この典型的な例は、半導体発光素子と半導体受光素子を組として一体化したダブレットタイプの光モジュールである。

【0013】

【実施例】図1は本発明に係る光モジュールの一実施例を示す説明図である。この例は、LC型又はMU型の規格に準拠した設計例である。球レンズ10を内蔵すると共に接続相手の光プラグのフェルール（図示せず）を嵌合保持する樹脂ハウジング12に、素子本体を上面窓付きのキャップで気密封止した光半導体素子（例えばレーザダイオード）14を接合することで製造する。その接合操作の際、光プラグ接続時に前記光半導体素子14とフェルールの光ファイバとが前記球レンズ10によって光学的に結合するように光軸の芯だしを行う。

【0014】樹脂ハウジング12は、全体がほぼ筒形状を呈する一体成形品であり、一方の端面12aが光半導体素子14の取り付け面、一端内側部分が球レンズ固定部、反対側がレセプタクル部16となっており、球レンズ固定部の外周には全周にわたって溝12bが形成され

ている。レセプタクル部16は、接続相手の光プラグのフェルールが丁度嵌入するボア（空洞部）18を有する部分である。この例では、フェルールを受け入れるボア18の内径は直径1.25mmである。

【0015】球レンズ固定部は、球レンズ10をスナップイン圧入あるいは接着・溶着等により固定できる構造である。例えばスナップイン圧入構造の場合は、この球レンズ固定部は、中心軸の周囲に、先端部が光半導体素子の方に向かって突出し且つ内周側に膨出（オーバーハング）した複数の爪状突起によって構成される。これらの爪状突起は、樹脂ハウジング本体部分とともに射出成形法によって一体的に成形される。球レンズ圧入時に、爪状突起は、樹脂の靱性によって外向きに撓んで内部に球レンズを受け入れ、該球レンズはレンズ着座面に当接して位置決めされる。その状態で、爪状突起は元の形状に戻ろうとし、その復元反力で該球レンズは抱持固定される。

【0016】このように球レンズ10を内蔵した樹脂ハウジング12に、光半導体素子14を取り付ける。ここで光半導体素子14は、そのキャップ上面（窓部14aの外周部分）14bが樹脂ハウジング12の端部12aに衝合し、最終的に最適な光学的位置になるように調芯位置決めされた状態で接着固定される。

【0017】本実施例では、この接着固定に紫外線硬化型接着剤20を用いている。光半導体素子のキャップ上面とハウジング端面との接着は、光半導体素子の熱的損傷を避けるために極力低温で行う必要があり、また光学的調芯後、短時間で固定することが好ましい。紫外線硬化型接着剤による接合は、このような条件を満たすことができるため最適である。この接着で、後工程でのハンドリングに十分な強度（引っ張り強度は19.6N以上）を確保できる。

【0018】紫外線硬化型接着剤の塗布状態を図2に示す。Aは樹脂ハウジングの半断面図であり、Bは平面図である。樹脂ハウジング12を、その一端面（光半導体素子に接合する端面）が上方を向くようにして、粘度45Pa・s程度の紫外線硬化型エポキシ接着剤（白色不透明、Tg=100℃）20を、自動又は手動の回転塗布機によって、ハウジング端面12aに円周状に塗布する。接着剤の塗布高さhは0.1~0.25mm程度である。

【0019】図3に具体的な接着操作の状態を示す。図2に示すように紫外線硬化型接着剤を塗布した樹脂ハウジング12を接着剤塗布面が上を向くように固定ステージ（図示するのを省略）に固定し、他方、光半導体素子（レーザダイオード）14をキャップ上面（窓部を有する面）が下方を向くように素子保持工具30で保持する。そして、ハウジング端面とキャップ上面とが50~250μm程度の空隙を維持した状態で光学的な芯出しを行う。即ち、光半導体素子（レーザダイオード）14

【図5】その組立説明図。

【図6】光モジュール本体のケーシングへの挿入状態を示す説明図。

【符号の説明】

10 球レンズ

12 樹脂ハウジング

14 光半導体素子

16 レセプタクル部

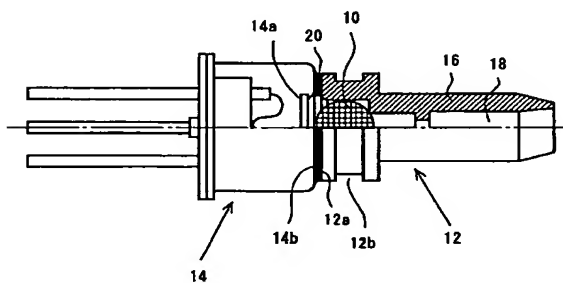
18 ボア

20 紫外線硬化型接着剤

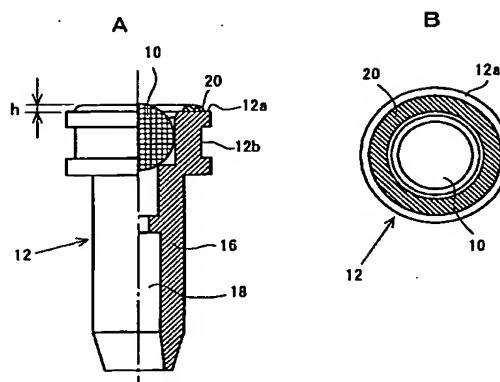
42 ケーシング

44 熱硬化型樹脂

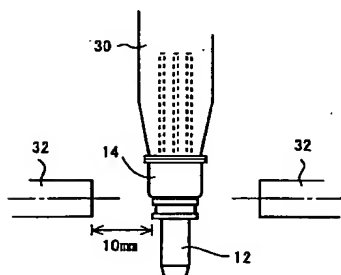
【図1】



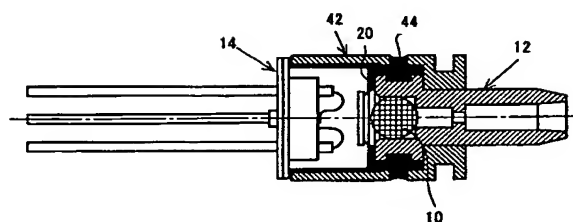
【図2】



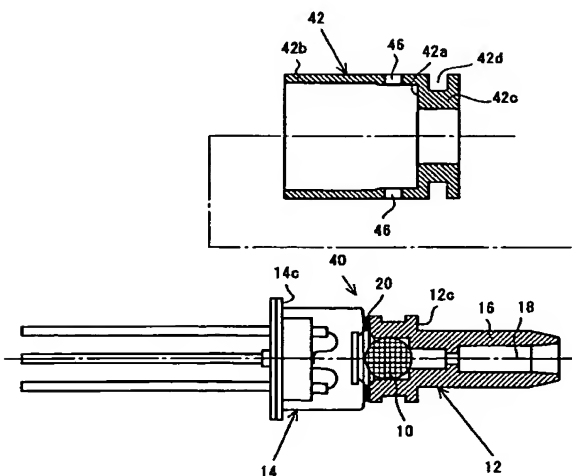
【図3】



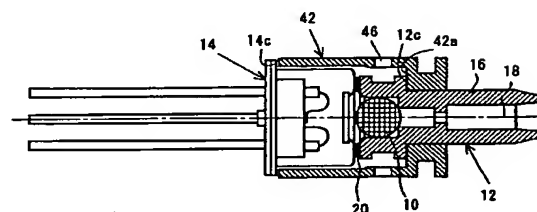
【図4】



【図5】



【図6】



フロントページの続き

Fターム(参考) 2H037 AA01 BA03 BA12 DA03 DA05
DA06 DA18 DA35
5F073 AB27 AB28 FA06
5F088 BA16 BA18 BB01 JA06 JA12
JA14 JA20